

安全评价报告信息公开表
 (杭州道铭微电子有限公司杭钱塘工出【2023】2号集成电路及功率
 器件系统集成封装新建一期厂房项目(一期项目)安全设施竣工验
 收评价报告)

被评价单位名称	杭州道铭微电子有限公司
评价项目名称/项目编号	天为(评)字23-03-35号
项目简介 (含图片)	<p>杭州道铭微电子有限公司成立于2021年5月10日，注册叁亿元整，注册地址位于中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道16号大街388号3幢11#库，法定代表人王敏文。经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p> <p>杭州道铭微电子有限公司为拓展市场，从产量和品种两方面更好地满足市场需求，提高公司产品国内外市场份额，新建了计算机、通信和其他电子设备制造业厂房，购置了高速贴片机、水洗机、固晶机、溅镀机、超声波清洗机、焊线机等国内外生产及辅助设备，用于生产集成电路及功率器件系统集成封装模组产品，计划建成杭钱塘工出【2023】2号集成电路及功率器件系统集成封装新建一期厂房项目，形成月产135kk集成电路及功率器件系统集成封装模组的生产能力。现杭州道铭微电子有限公司已形成一期月产60kk集成电路及功率器件系统集成封装模组的生产能力，未完成的月产75kk集成电路及功率器件系统集成封装模组的生产能力为二期完成。</p> <p>杭州道铭微电子有限公司在生产过程中使用到危险化学品氢气、氢氧化钠、助焊剂(异丙醇50%)、去毛刺</p>

	<p>液（二乙烯三胺 5-10%、水合肼 10-20%）、去氧化物粉剂（过硫酸氢钠>50%）、去氧化粉（过硫酸氢钠>80%）、电解解除胶剂（氢氧化钾 30-80%）、电解退锡剂（甲基磺酸≥20%）、退锡剂（硝酸 20-40%）、化学退锡液（甲基磺酸 50-60%）、锡络合剂（甲基磺酸≥70%）、去氧化物溶液（硫酸<20%）、无水乙醇、正丙醇、异丙醇、清洗液（二氯甲烷>85%）、氩[压缩的]、氩氧混合气（氩气 99-52%、氧气 1-48%）、甲酸、硫酸、过氧化氢溶液（30%）、发烟硝酸、盐酸、氮[压缩的]，其产品未列入《危险化学品目录》（2015 年版，2022 年第 8 号公告修订），故该企业属于危险化学品使用企业。根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，国务院令第 645 号修订）、《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 57 号，第 89 号令 2017 年修订）、《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019 修订版），本企业所在的行业属于集成电路制造（3973），未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》（2013 年版），且使用危险化学品从事生产的使用量未达到规定数量，因此，不需要领取危险化学品使用许可证。</p> 
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司
项目组长	胡伟
技术负责人	周玉飞

过程控制负责人	王小梅	
评价报告编制人	赵晨	
报告审核人	贝少华	
参与评价工作	安全评价师	胡伟、赵晨、邵东卫、余红光、卜伟华、刘咏梅
	注册安全工程师	胡伟、赵晨、邵东卫
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	胡伟、刘咏梅
	时间	2025年10月17日至2025年12月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间	2025年12月	